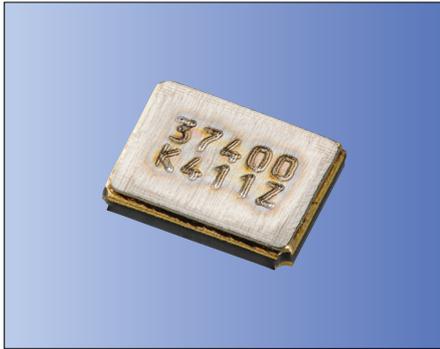




表面贴装型 CX1612DB (消费类电子产品应用/移动通信应用)

1.6×1.2mm



RoHS指令对应产品

■特点

- 数字家电·消费类电子产品应用晶体谐振器
- 小型、薄型  
32MHz或更高可对应0.35mm以下的高度
- 陶瓷封装
- 可对应回流焊

■用途

- 智能手机(Bluetooth®、无线LAN、NFC)
- 可穿戴设备
- 近距离无线(LPWA)

※Bluetooth®是Bluetooth SIG Inc.(美国蓝牙公司)的注册商标。

■型号表示方法

CX1612DB 24000 □□ G L L CC  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①系列名称  
②频率  
③负载容量  
④频率容差(常温偏差)

D0 8 pF  
G ±15×10<sup>-6</sup>

⑤工作温度范围以及⑥频率温度特性  
LL -30 ~ +85° C ±20×10<sup>-6</sup>

⑦个别规格(产品目录以CC标示)

包装方式(载带包装 3000/ 20000个卷盘)

■规格

| 项目     | 记号               | 标准规格                                 | 单位                | 备注            |
|--------|------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|
| 频率     | f <sub>nom</sub> | 24 / 26 / 32 / 37.4 / 38.4 / 40 / 48 | MHz               | 其他频率, 敬请咨询。   |
| 泛音次数   | OT               | Fundamental                          | —                 |               |
| 负载容量   | CL               | 8                                    | pF                | 其他负载容量, 敬请咨询。 |
| 频率容差   | f <sub>tol</sub> | ±15                                  | ×10 <sup>-6</sup> | 25° C ±3° C   |
| 串联电阻   | R1               | Table 1                              | ohm               |               |
| 激励级    | DL               | 10μW(100μW max.)                     | μW                |               |
| 工作温度范围 | T <sub>use</sub> | -30 ~ +85                            | °C                |               |
| 储存温度范围 | T <sub>stg</sub> | -40 ~ +85                            | °C                |               |
| 频率温度特性 | f <sub>tem</sub> | ±20                                  | ×10 <sup>-6</sup> | 对于25°C频率的偏差   |

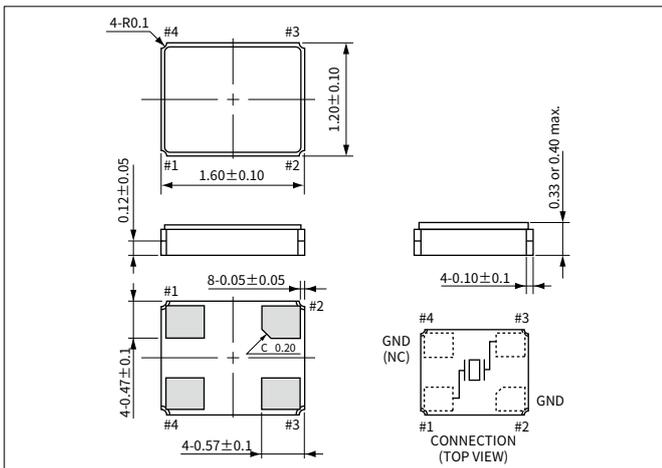
以上规格为规格示例, 如需其他规格, 敬请咨询。

■Table1 串联电阻 其他频率, 敬请咨询。

| 频率      | 串联电阻      |
|---------|-----------|
| 24MHz   | 150Ω max. |
| 38.4MHz | 80Ω max.  |
| 48MHz   | 50Ω max.  |

■外形尺寸

(单位: mm)



■推荐焊盘图案

(单位: mm)

